

8412 ACF



Information Produit

Film adhésif structurel conducteur anisotrope ambré de 50 µm

Description produit

tesa HAF® 8412 est un film adhésif structurel ambré activable à chaud à base de résine phénolique et de caoutchouc nitrile contenant des particules conductrices.

Caractéristiques

- Excellente performance de mise à la terre dans les applications exigeant une fixation structurelle
- Grande force de collage dans les zones de fixation étroites et petites
- Bonne résistance au vieillissement
- Fixation fiable de la puce dans la carte à puce et connectivité électrique en une seule étape
- Compatibilité avec les cartes (DI) PVC, ABS et PC

Application

tesa HAF® 8412 convient particulièrement à l'implantation de puces électroniques dans des cartes à puces à surfaces antagonistes pour des applications avec et sans contact et des applications de mise à la terre exigeantes dans l'électronique grand public.

Informations techniques (valeurs moyennes)

Les valeurs dans cette section doivent être considérées comme représentatives ou standards uniquement et ne doivent pas être utilisées à des fins spécifiques.

Conception du produit

- | | | | |
|--------------------------|--|--------------------|-------|
| • Support | aucun | • Epaisseur totale | 50 µm |
| • Type de masse adhésive | caoutchouc nitrile/
résine phénolique | • Couleur | ambre |
| • Type de protecteur | glassine | | |

Propriétés / Valeurs de performance

- | | | | |
|--|---------------------|----------------------------|--------|
| • Force de collage | 4 N/mm ² | • Température d'activation | 120 °C |
| • Résistance de contact -
direction z | 200 mOhm | | |

Infos complémentaires

Recommandations techniques :

Les valeurs suivantes sont recommandées pour le paramétrage des machines. Veuillez noter que les paramètres optimaux dépendent énormément du type de machine, des matériaux particuliers pour les corps des cartes et des modules de puces ainsi que des exigences des clients.

Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://l.tesa.com/?ip=08412>

8412

ACF

Information Produit

Infos complémentaires

Intégration de modules de puces dans des cartes à puces à surfaces antagonistes

1. Pré-laminage :

L'adhésif est laminé sur le substrat en métal. L'étape de pré-laminage n'affecte pas la durée de conservation. Les rouleaux de modules laminés se conservent comme le ruban adhésif seul.

Paramètres de la machine : Température 130 – 150 °C, Pression 2 – 3 bar, Vitesse 1,5 – 2,5 m/min

2. Implantation du module

Pendant l'étape d'implantation, les modules ayant été prédécoupés, sont placés dans les cavités créées à cet effet et collés de façon permanente sur le corps de carte par chaleur et pression. Selon le type de ligne utilisé, il est possible de recourir à un procédé en une ou plusieurs étapes. Aujourd'hui, la plupart des machines d'implantation comportent plusieurs étapes de pressage à chaud.

Procédé en une seule étape

Paramètres de la machine : Température¹ 180 – 220 °C, Pression 80 – 130 N/module, Durée 1,5 s

3. Procédé à plusieurs étapes (2 tampons chauffants ou plus)

Paramètres de la machine : Température¹ 180 - 220 °C, Pression 80 - 130 N/module, Durée 2 x 0,7 s / 3 x 0,5 s

¹Les recommandations de température se réfèrent à ce qui peut être mesuré à l'intérieur du tampon chauffant. Différents réglages de température sont recommandés en fonction du matériau de la carte :

- PVC 180 – 190 °C
- ABS 180 – 190 °C
- PET 190 – 200 °C
- PC 200 – 220 °C

Applications de mise à la terre dans l'électronique grand public

1. Pré-laminage : Lors du pré-laminage, le ruban est laminé sur un seul composant.

Paramètres de la machine : Température¹ ≥ 120 °C, Pression² ≥ 5 bar, Durée ≥ 5 s

2. Collage : Retirer le protecteur du ruban après l'étape de pré-laminage. Placer le composant pré-laminé sur le substrat sur lequel il doit être fixé. Appliquer une température suffisante tout en exerçant une pression pendant la durée de collage afin d'obtenir une force adhésive suffisante.

Paramètres de la machine : Température² 120-250 °C, Pression³ 5-30 bar, Durée 5 s – 3 min

Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://l.tesa.com/?ip=08412>

8412 ACF

Information Produit

Infos complémentaires

² Les températures de pré-laminage et de collage se réfèrent aux données mesurées dans la ligne de collage. ³ Les pressions de pré-laminage et de collage se réfèrent à la force transformée de la surface du gabarit directement sur la zone de fixation. Les valeurs de force d'adhérence ont été obtenues dans des conditions de laboratoire standard. (matériau : échantillon test en aluminium gravé/conditions de fixation : température = 180 °C ; pression = 10 bar ; durée = 7 sec). Pour obtenir un pouvoir adhésif optimal, les surfaces doivent être propres et sèches.

Avertissement

Tous les produits tesa® sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresses ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.



Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://l.tesa.com/?ip=08412>